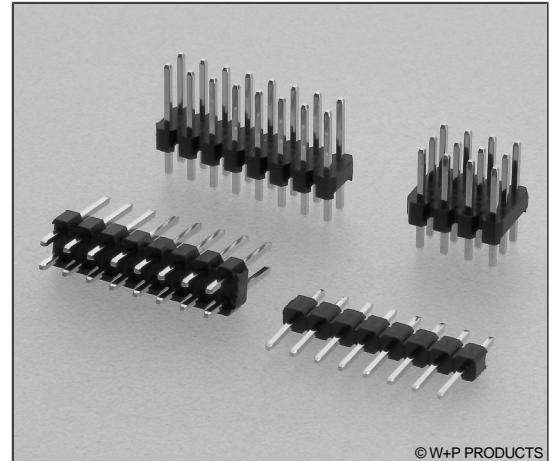


943 / 944 / 945

Stiftleisten RM 2,54mm, gerade, 1-/2-/3-reihig
Pin Headers, 2.54mm Pitch, Straight, 1/2/3 Rows

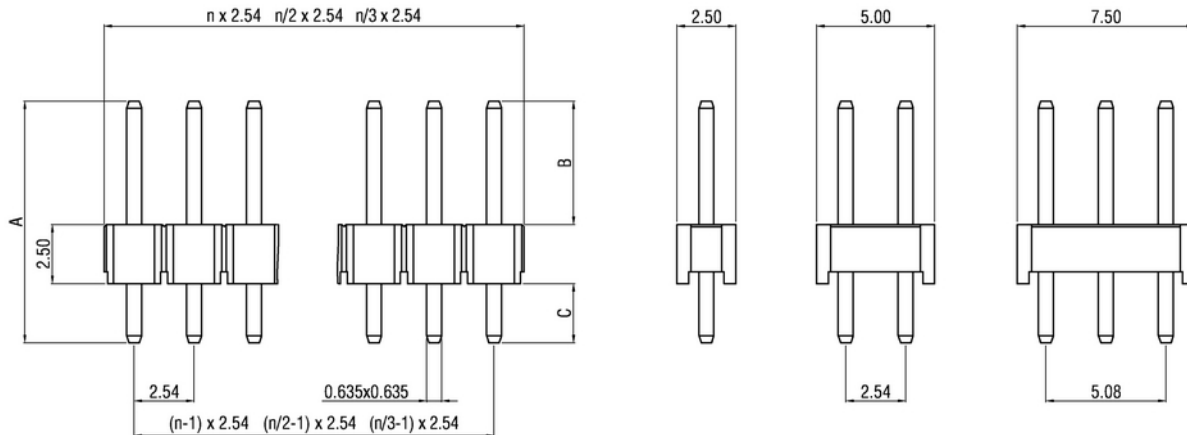
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>0.635mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A <i>IEC 60512-12A</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ <i>< 20mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>> 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1kV _{DC} <i>1kV_{DC}</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250V _{AC} <i>250V_{AC}</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3A <i>3A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C ... +125°C <i>-40°C ... +125°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
153 154 157 159 160/162 349 624 etc.
Weitere siehe Kapitel B
Please see ch. B for more



PCB Layouts und Detailzeichnungen s. tech. Informationen / Seite A12
Please note tech. information / page A12 for PCB layouts and detailed drawings.

Series*	Dimensions*	Contacts*	Plating*
944	10	010	00
Gestanzte/geprägte Kontakte <i>Stamped/formed contacts</i>	10 A=10,20 B=5,20 C=2,50mm 11 A=10,80 B=5,80 C=2,50mm 12 A=11,30 B=5,50 C=3,30mm 13 A=12,60 B=6,80 C=3,30mm 14 A=13,90 B=8,10 C=3,30mm 15 A=14,70 B=8,90 C=3,30mm 16 A=17,70 B=11,90 C=3,30mm 17 A=19,80 B=14,00 C=3,30mm 18 A=21,60 B=15,80 C=3,30mm 19 A=22,80 B=17,00 C=3,30mm 20 A=24,90 B=19,10 C=3,30mm Max. Stiftlänge: 72,5mm <i>Max. Pin Length: 72.5mm</i>	001-050 Einreihig <i>Single row</i> 004-100 Zweireihig <i>Double row</i> 009-120 Dreireihig <i>Triple row</i>	00 Vergoldet <i>Gold plated</i> 110 Sel. Au 0,25µm / flash 130 Sel. Au 0,75µm / flash 50 Verzinkt <i>Tin plated</i> 66 Sel. Au / Sn 610 Sel. Au 0,25µm / Sn 80 Sel. Au 0,75µm / Sn Au flash = min. 0,025µm

Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl.
Raster 5,08mm, 7,62mm, etc. oder Sonderraster sowie
weitere Stiftlängen und Abmessungen auf Anfrage.

*We will manufacture the pin headers in every desired
number of contacts. 5.08mm, 7.62mm, etc. and varying
itches as well as more dimensions on request.*

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* *This is an order example -
please replace by your specifications.*

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wppro.com
WEBSITE www.wppro.com

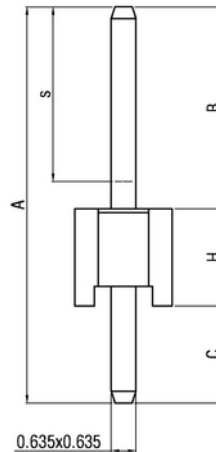
Stiftleistenmaße und PCB Layouts für 0,635mm Vierkantstifte

Dimensions and PCB Layouts

Gerade Stiftleisten / Straight Pin Headers

- A : Gesamtstiftlänge / Overall Pin Length
- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

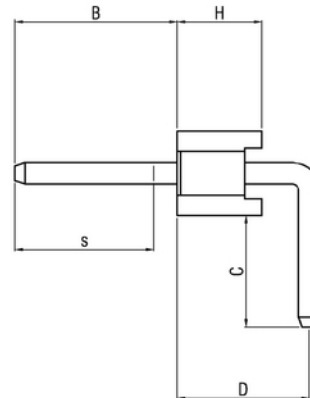
Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze.
 Test point for s at 2-4mm from contact tip.



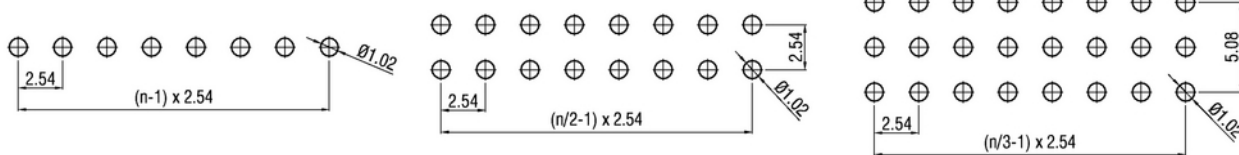
Gewinkelte Stiftleisten / Right-Angled Pin Headers

- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- D : Abstand zu Steckseite / Distance to Mating Side
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze.
 Test point for s at 2-4mm from contact tip.



PCB Layouts



Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

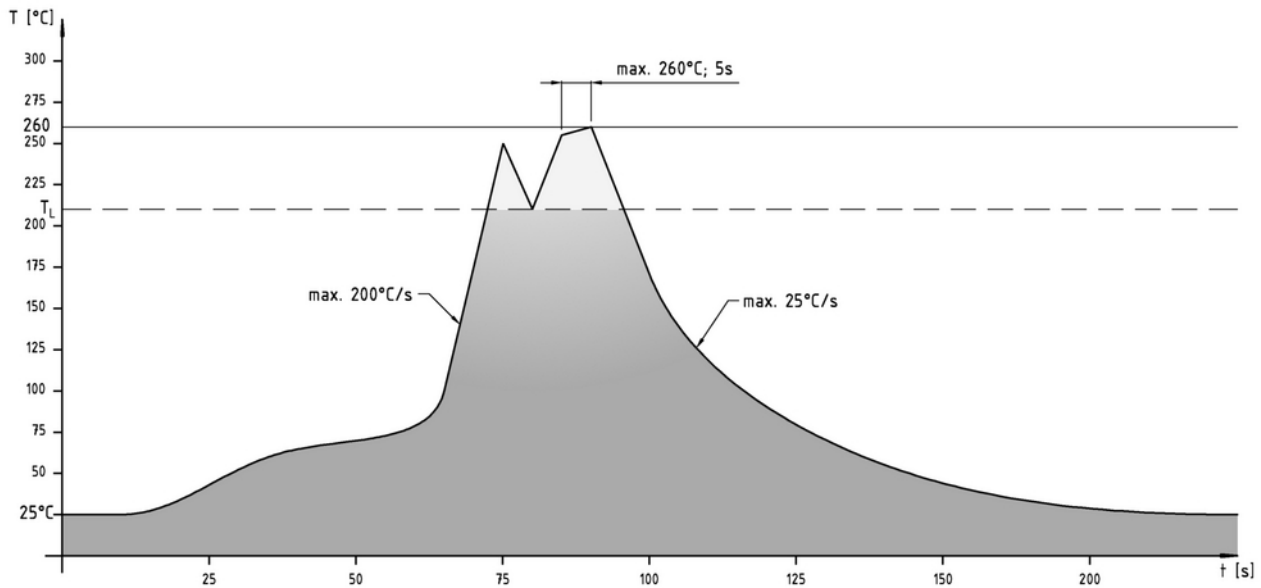
Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:

Recommended wave soldering profile:



Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

